

合肥颀中科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-010

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演/反路演活动 ☒ 现场参加 ☒ 电话会议 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
来访单位名称	国海证券、汇添富基金
时间	2025 年 10 月 31 日
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强 证券事务代表：陈颖
投资者关系活动主要内容介绍	1.问：公司 OLED 的客户结构？ 答：目前主要有瑞鼎、云英谷、集创北方、联咏、昇显微、芯颖、奕斯伟、禹创等客户。 2.问：铜镍金凸块应用非显示驱动芯片和显示驱动芯片的优势？ 答：铜镍金凸块是对传统引线键合（Wire bonding）封装方式的优化方案。具体而言，铜镍金凸块可以通过大幅增加芯片表面凸块的面积，在不改变芯片内部原有线路结构的基础之上，对原有芯片进行重新布线（RDL），大大提高了引线键合的灵活性。此外，铜镍金凸块中铜的占比相对较高，因而具有天然的成本优势。由于电源管理芯片需要具备高可靠、高电流等特性，且常常需要在高温的环境下使用，而铜镍金凸块可以满足上述要求并大幅降低导通电阻，因此铜镍金凸块目前主要应用于电源管理类芯片。 显示驱动芯片方面，因对性能要求高，主要使用金凸块，但是金材料带来了高成本，铜镍金凸块制造技术不断突破创新，公司扩展了铜镍金凸块在显示驱动芯片的应用，实现了高精度、高可靠性、微细间距的技术水平，同时大幅降低了材料成本。 3.问：公司的竞争优势？ 答：（1）出众的技术研发和自主创新优势，在显示驱动芯片封测领域，凭借多年来的研发积累和技术攻关，公司掌握了“微细间距金凸块高可靠性制造技术”、“测试核心配件设计技术”

等一系列具有自主知识产权的核心技术，覆盖了凸块制造、晶圆测试和后段封装测试等全部工艺流程。同时，公司具备双面铜结构、多芯片结合等先进 COF 封装工艺，并在业内前瞻性地研发了“125mm 大版面覆晶封装技术”，可以成倍增加所封装芯片的引脚数量，适用于高端智能手机 AMOLED 屏幕。目前，公司已具备业内最先进 28nm 制程显示驱动芯片的封测量产能力，相关技术为高端芯片性能的实现提供了重要保障。此外，公司将凸块技术延伸至电源管理芯片、射频前端芯片等非显示类芯片封测领域。公司围绕铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等领域开发出“低应力凸块下金属层技术”、“微间距线圈环绕凸块制造技术”、“高厚度光阻涂布技术”、“真空落球技术”等多项核心技术。同时，面对“后摩尔时代”芯片尺寸越来越小、电性能要求越来越高的技术发展趋势，公司建立了 DPS 和载板覆晶封装制程，助力实现更小尺寸和更高集成度的整套封装测试的解决方案。同时，公司依托在金属凸块技术方面的深厚积累，积极布局功率芯片前段正面金属化（FSM）、背面减薄及金属化（BGBM）工艺以及后段铜片夹扣键合（Cu Clip）封装工艺，以满足功率器件大电流、低导通阻抗的特性。

（2）公司具备技术改造和软硬件开发的优势，公司一直致力智能制造的投入与专业人才的培养，拥有一支 20 余人的专业化团队，具备较强的核心设备改造、配件设计以及自动化系统开发能力。在核心设备改造方面，公司自主设计并改造了一系列适用于 125mm 大版面覆晶封装的相关设备，为大版面覆晶封装产品的量产奠定了坚实基础，并自行完成了核心 8 吋 COF 设备的技术改造以用于 12 吋产品，大幅节约了新设备购置所需的时间和成本。

（3）公司拥有经验丰富、具有创新精神的管理团队，公司的经营管理团队主要来自内部培养，具有较高的人员稳定性，同时主要成员在集成电路先进封测行业拥有超过 15 年以上的技术研发和生产管理经验，具备国际一流先进封测企业的视野和产业背景。经验丰富且稳定的管理团队，有利于公司继续保持在行业内的领先地位，不断提升公司品牌效应。

（4）公司拥有优质的客户资源，公司凭借领先的技术实力和稳定的产品质量，在显示驱动芯片封测领域积累了大量优质客户资源。在境外客户方面，公司与联咏科技、奇景光电、瑞鼎科

	技、敦泰电子、谱瑞科技等国际知名显示驱动芯片设计公司建立了长期稳定的合作关系。这些客户在全球显示驱动芯片市场占据重要地位。在境内客户方面，公司长期服务了集创北方、奕斯伟计算、格科微、云英谷、豪威科技、通锐微等快速成长的本土企业，随着国产化进程加快，这些本土企业的市场份额持续提升。 4.问：公司的价格趋势如何？ 答：目前综合考量下，公司预计仍以保持价格的稳定为优先。后续，公司将视市场供需情况，再做进一步评估。 5.问：公司目前订单能见度？ 答：目前公司客户一般约提供 3 个月的需求预测。 6.问：公司高端测试机的扩产计划？主要从哪里进机？ 答：目前公司的高阶测试机仍在持续进机中；进机台的速度和数量则会根据目前订单的掌握情况并兼顾设备供应商的交期和出货数量限制等因素，综合考虑后弹性调整。公司目前主要从爱德万进机。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 11 月 3 日